

2024-2030年中国驱动IC用COF行业发展监测及投资战略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2024-2030年中国驱动IC用COF行业发展监测及投资战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/electric/1013374.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

《2024-2030年中国驱动IC用COF行业发展监测及投资战略研究报告》由华经产业研究院研究团队精心研究编制，对驱动IC用COF行业发展环境、市场运行现状进行了具体分析，还重点分析了行业竞争格局、重点企业的经营现状，结合驱动IC用COF行业的发展轨迹和实践经验，对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判；为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据、海关总署、问卷调查数据、商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场分析数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 COF产品概述

第一节 COF的定义

第二节 COF品种

第三节 COF——目前的主流挠性IC封装形式

一、IC封装

二、IC封装基板与常规印制电路板在性能、功能上的差异

三、IC封装基板的种类

第四节 COF与TAB、TCP、TAPE BGA/CSP在定义上的区别

第五节 COF在驱动IC中的应用

第六节 COF行业与市场发展概述

第二章 COF的结构及其特性

第一节 COF的结构特点

第二节 COF在LCD驱动IC应用中的特性

第三节 COF与其它IC驱动IC封装形式的应用特性对比

一、COF与COG比较

二、COF与TAB比较

第四节 未来COF在结构及其特性上的发展前景

一、制作线宽/线距小于30 μ M的精细线路封装基板

二、卷式（ROLL TO ROLL）生产方式的发展

三、多芯片组装（MCM）形式的COF

第五节 COF的更高阶封装形式——基于挠性基板的3D封装的发展

- 一、从2D发展到3D的挠性基板封装
- 二、基于挠性基板的3D 封装的主要形式

第三章 驱动IC产业现状与发展

第一节 驱动IC的功能与结构

一、驱动IC的功能及与COF的关系

- 1、驱动IC的功能
 - 2、驱动IC与COF的关系
- #### 二、驱动IC的结构
- #### 三、驱动IC的品种

第二节 驱动IC在发展LCD中具有重要的地位

第三节 大尺寸TFT-LCD驱动及其特点

- 一、大尺寸TFT-LCD驱动特点
- 二、大尺寸TFT-LCD驱动芯片设计难点

第四节 驱动IC产业的特点

第五节 世界显示驱动IC的市场现况

- 一、显示驱动IC制造厂商与下游LCD面板厂家的关系及分析
- 二、世界显示驱动IC设计业现况
- 三、世界显示驱动IC市场规模调查统计

第六节 世界显示驱动IC主要生产厂家的现况

第四章 液晶面板应用市场现状与发展

第一节 世界液晶面板市场规模与生产情况概述

- 一、世界液晶面板市场变化
- 二、世界面板市场品种的格局
- 三、中、日、韩面板产业发展及趋势预测

第二节 世界大尺寸TFT-LCD应用市场发展现况

- 一、世界大尺寸面板市场规模总述
- 二、液晶电视领域对大尺寸面板的需求状况分析
- 三、平板电脑领域对大尺寸面板的需求状况分析
- 四、显示器领域对大尺寸面板的需求状况分析
- 五、对2023年世界大尺寸面板市场需求的预测分析

第三节 中国液晶面板市场规模与生产情况概述

- 一、中国驱动IC设计行业的状况分析

二、中国液晶面板产业的发展

三、中国液晶面板生产现况与未来几年发展预测分析

第五章 COF的生产工艺及技术的发展

第一节 COF制造技术总述

一、COF的问世

二、COF的技术构成

第二节 COF挠性基板的生产工艺技术

一、COF挠性基板生产的工艺过程总述及工艺特点

二、挠性基板材料的选择

三、精细线路的制作

第三节 IC芯片的安装技术

第四节 COF挠性基板的主要性能指标

第六章 世界COF基板的生产现状分析

第一节 全世界COF基板生产量统计

第二节 全世界COF市场格局

第三节 全世界COF基板主要生产厂家

第四节 全世界COF基板主要生产状况分析

一、日本COF基板厂家

二、韩国COF基板厂家

1、韩国LG MICRON

2、韩国STEMCO

三、中国台湾COF基板厂家

1、中国台湾欣邦

2、中国台湾易华

第七章 中国COF基板的生产现状分析

第一节 中国FPC业的现状分析

第二节 中国COF的生产现况

第三节 中国COF基板的生产企业现况

一、深圳丹邦科技股份有限公司

1、企业发展简况分析

2、企业经营情况分析

3、企业经营优劣势分析

二、深圳市三德冠精密电路科技有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业经营优劣势分析

三、上达电子（深圳）股份有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业经营优劣势分析

四、厦门弘信电子科技集团股份有限公司

- 1、企业发展简况分析
- 2、企业经营情况分析
- 3、企业经营优劣势分析

第八章 COF挠性基板用二层型挠性覆铜板特性与生产现状分析

第一节 二层型挠性覆铜板品种及特性

第二节 挠性覆铜板产品主要采用的标准及性能要求

- 一、适用于FCCL的中国国家标准介绍
- 二、国际上广泛使用的FCCL标准介绍
 - 1、IPC标准
 - 2、IEC标准
 - 3、日本标准
 - 4、测试方法比较
- 三、实际产品应用中的性能要求

第三节 挠性覆铜板的生产工艺

- 一、三层型挠性覆铜板的生产工艺
 - 1、片状制造法
 - 2、卷状制造法
- 二、二层型挠性覆铜板的生产工艺
 - 1、涂布法（CASTING）
 - 2、层压法（LAMINATION）
 - 3、溅镀法（SPUTTERING/PLATING）

第四节 世界挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

- 一、总述
- 二、日本FCCL业生产现状与发展
- 三、美国、欧洲FCCL业的现状与发展

四、中国台湾FCCL业的现状与发展

五、韩国FCCL业的现状与发展

第五节 中国国内挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

一、中国国内挠性覆铜板业发展总述

二、中国国内挠性覆铜板生产厂家现况

图表目录：

图表：三种封装基板的CTE及对CCL的CTE要求

图表：COF与COG比较分析

图表：COF与TAB比较分析

图表：2019-2023年世界显示驱动IC市场规模调查统计

图表：世界显示驱动IC主要生产厂家分析

图表：2019-2023年全球主流面板厂商分区域销售额走势（单位：十亿美元）

图表：2019-2023年全球大尺寸面板出货数量及同比走势（单位：百万台，%）

图表：2019-2023年全球大尺寸面板分应用平均尺寸走势（单位：英寸）

图表：2024-2030年全球液晶电视面板平均尺寸走势（单位：英寸）

图表：2024-2030年全球液晶电视面板分分辨率占比走势（%）

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/electric/1013374.html>